1/5/7
DIALOG(R) File 352: Derwent WPI
(c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008870589

WPI Acc No: 1991-374616/199151

XRAM Acc No: C91-161675

Carousel type sputtering appts. - has polygonal rotation drum between substrates and two cathode poles obtaining uniform film thickness

Patent Assignee: UBE IND LTD (UBEI)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date JP 3253568 19911112 JP 9051872 Α 19900305 Α 199151 JP 95068614 B2 19950726 JP 9051872 Α 19900305 199534

Priority Applications (No Type Date): JP 9051872 A 19900305
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
JP 95068614 B2 9 C23C-014/34 Based on patent JP 3253568

Abstract (Basic): JP 3253568 A

In the carousel type sputtering appts., a polygonal rotation drum disposed with substrates in each side face respectively is prepd. At least two rectangular cathode poles, one of which has anticlockwise direction w.r.t. the drum section surface, and another pole has clockwise direction is also prepd.

ADVANTAGE - Without enlarging the appts., large surface area substrate is useable to obtain uniform film thickness. (9pp

-wg. No. 0/12)

Title Terms: CAROUSEL; TYPE; SPUTTER; APPARATUS; POLYGONAL; ROTATING; DRUM; SUBSTRATE; TWO; CATHODE; POLE; OBTAIN; UNIFORM; FILM: THICK

Derwent Class: M13

International Patent Class (Main): C23C-014/34

International Patent Class (Additional): C23C-014/54

File Segment: CPI

?LOGOFF

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-253568

Silnt. Cl. 5

識別記号

❸公開 平成3年(1991)11月12日

C 23 C 14/54 14/34 庁内整理番号 9046-4K 9046-4K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全9頁)

❸発明の名称

カルーセル形スパッタリング装置およびそのスパツタリング方法

②特 願 平2-51872

❷出 類 平2(1990)3月5日

⑩発明者 中島

晃 治

山口県宇部市大字小串字冲の山1980番地 宇部興産株式会

社宇部機械製作所内

@発明者 山元

公 純 山口県

山口県宇部市大字小串字沖の山1980番地 宇部興産株式会

社宇部機械製作所内

勿出 顋 人 宇部興産株式会社

山口県宇部市西本町1丁目12番32号

砂代 理 人 弁理士 山川 政樹 外3名

明細音の許古(内容に変更なし)

明 組 書

1. 発明の名称

カルーセル形スパッタリング設置およびそのス パッタリング方法

2. 特許請求の範囲

(1) 多角形ドラムの外周上に平板状态板をその 表面が正多角形の一辺となるように取り付けて円 周方向に回転させる正多角形回転ドラムと、前記 正多角形回転ドラムの中心方向に向けて一方は中 心に向う機に対して時計廻り方向に他方は反時計 廻り方向に角度をもたせて配置した少なくとも2 個の矩形状カソード電極部とを備えたことを特徴 とするカルーセル形スパンタリング製量。

(2) 請求項1 にかいて、前記矩形状カソード電 極部の各ターゲット上面のリニアプラズマによつ てスペッタされたスペッタ原子を前記平板状基板 上に重ね合わせて成膜を行なうことを特徴とした スペッタリング方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はカル・セル形スパッタリング装置およびそのスパッタリング方法に保わり、特にそのカソード構造およびそのカソード構造を用いた成膜方法に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、との性のスペッタリング装置は、正多角形の回転ドラムの側面にプレート状基板もしくは 複数枚の円板状基板を取り付け、矩形ターゲット の長手方向とドラム回転軸とが平行となるように 矩形ターゲットを配置し、側面に基板を取り付け た状態で正多角形ドラムを回転させながら、基板 上に皮膜を行なつていた。

[発明が解決しようとする経題]

従来の矩形カソード構造を有したカルーセル形 スパッタリング要便を用いて成膜を行たう場合、 基板ホルダーを正多角形回転ドラムの円周上に回 転させるので、正多角形の数にあたる部分と辺に あたる部分とでは、ターゲットとの最短接近距離 とターゲットに対する角度との関係が異なるため、 ターゲット上面のプラズマによつてスパッタされ たスパッタ原子の基板への付着確率が異なり、等 返回転では基板幅方向の膜厚分布が不均一となる 問題があつた。

〔課題を解決するための手段〕

このような課題を解決するために本発明によるカルーセル形スパッタリング装置は、多角形ドラムの外周上に平板状蓄板をその表面が正多角形の一辺となるように取り付けこの多角形ドラムを円周方向に回転させる正多角形回転ドラムと、この多角形回転ドラムの中心方向に向けて一方は中心に向う線に対して時間廻り方向に他方は反時計廻り方向に角度をもたせて配置した少なくとも2個の矩形状カソード電極部とを有している。

本発明によるスパッタリング方法は、矩形カソード電極部の各ターゲット上面のブラズマリングによってスペッタされたスペッタ原子を、平板状態板上に重ね合わせることにより成膜を行なりものである。

〔作用〕

本発明にかいては、各矩形状カソード電観部の

+0)を有して配置された矩形ターグット、51,52 は各矩形ターグット41,42 の矩形電極部、61,62 は中央磁極、71,72 は各中央磁極61,62 を囲む外周磁極、81,82 は各中央磁極61,62 と外周磁極71,72 とによつて形成される磁力線、81,92 は磁力線81,82 によつて封じ込められているほぼ長トラック状プラズマリング、10 は電極部51,52 に電力を投入する高圧電源、11 は真空容器である。

このような構成において、回転ドラム1の側面 に複数の基板2を取り付け、この正多角形回転ド ラム1を矢印D方向へ回転させながら、矩形ター ゲット4:,4:の上面の長トラック状プラズマリ ング3:,3:によつてスパッチされたスパッチ原 子が重ね合わされて大面積蓄板2上にほぼ均一な 度厚分布で成膜される。また、成膜範囲はシャッ チ-3によつて調整されている。

一般にスペッタ原子の基板への付着確率は、コ サイン則によつて支配されており、ターゲット上 のプラズマリングの位置から基板面内の各位置ま 時計組り角度(以下、より角と呼ぶ)を適正値に 選定することにより、平板状蓄板上に均一た膜厚 分布で成膜される。

〔寒荡例〕

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に説明ナス

第1図は本発明によるカルーセル形スパッタリンク装置の一実施例による構成を説明する図の的はり、同図(a)は全体の構成を示す斜視図、同図(b)は同図(a)ののAーA/線の断面図、同図(d)は同図(c)のBーB/線の断面図である。同図にかいて、1は複数の断面図である。同図にかいて、1は複数の断面図である。同図にかいてを中心として変数であり付けての極いである。同図になり付けての極いであり付けての極いであり付けての極いでありがある。別に変する正多角形のに変する正多角形のに変するになりである。 3 はスパッタ粒子の斜め入射をカックム、2 は回転ドラム1の傾面に取り付入射をカックム、3 はスパッタ粒子の斜め入射をカックムに発展調整可能なシャッター、4 1、4 1 はシャッター3 の第口部内に回転軸にと直角方向に始よて正方向に角度(一)。

ての距離とそのなす角度に分布があれば、付着確 率が異なり、襲厚分布が生じてしまう。従来のカ ルーセル形スパツタリング装置にかいては、正多 角形回転ドラムを回転しながら、成膜を行つた場 合、第2図(a)に示す基板2の中心部と同図(b)に示 す基板2の端にもたる角の部分とでブラズマリン グョからの最短接近距離とプラズマリング3に対 する角度とに差が生じ、基板2の幅方向で膜厚が 不均一となつていた。とれに対して本実施例では、 シャッター3の開口部内に矩形電極部51,51を 開口部中心線に対して対称にかつふり角を置いて 配置し、各矩形ターゲット41,42の上面の長ト ラック状プラメマリング 81 , 82 化よつてスパツ タされたスペッタ原子が重ね合わされ、その結果 として第3図に示すように譲厚均一化が実現でき る。つまり同図はた示す矩形メーグツト4:によ る腹厚分布 4 、と、同図(b)に示す矩形ターゲット 4。による膜厚分布 d。とを重ね合わせた同図(c) に示す農庫分布4』となる。しかし、対称に配置 した矩形電艦部51,52のふり角を小さくすると、 第4図に
第4図に
第3図と
同様の方法で
説明すると各矩形

メーゲット 41・42 の上面の長トラック 株プラズ
マリング 51・52 による
膜厚分布 61・62 にかり
面ね合わせた
膜厚分布 62 を同図(c) に示すように
中央山高の分が同型を
かってしまう。また、矩形電配し、
中央山高の分布となってしまう。また、近近を
部51・52 のより角を大きくしすぎると、逆症にし、
外別が高い
膜厚分布 61・62 に対すとなる。
道正値が
存在してかり、その値は
基板2の配列程、正多角
形回転ドラム1の分割数
板2との間の
距離など
により、一銭的に
決めることができる。

次に本実施例について以下の速転条件により膜 厚分布の均一化について説明する。

(比較例の運転条件)

ターゲットの外種寸法 5 インチ×1 8 インチ (127 m× 457 m), マグネトロン磁値にて対じ 込められた長トラック状プラズマリング, 蓋板寸

マグネトロン磁板にて長トラック状プラズマリング 81,82,基板寸法300 == ×300 == のブレート 状态板,基板寸法300 == ×300 == のブレート 状态板,基板とターゲットとの間の最短接近距離 60 == ,アルゴンガス圧力10 =Terr ,ターゲットとしてCo を使用,六角形回転ドラムの直径60 cm,シャッター 関度90度,放電電流・回転速度・ 放襲時間は任意として成蹊を行ない、第8 図は基板中央高さ位置での個方向の裏厚分布を求めたものでもる。 両図から明らかをように30 cm角の基で内で幅方向に±25 ぎまでに膜厚均一化がなされたことが判る。

第9図は本発明に係わるカルーセル形スパッタリング装置の他の実施例による構成を説明する図で同図(a)は全体の構成を示す図、同図(b)は同図(a)の電極部の外形を示す斜視図、同図(d)は同図(c)のB-B'練の断面図であり、前述の図と同一部分には同一符号を付してある。同図にかいて、5は矩形ターゲット41,42の電極部、12はリング状の外周磁極、13は内局磁極12を囲むリング状の外周磁極、

佐300 m× 300 mのプレート状態板、基板とメーゲットとの間の最短級近距離60 mm、アルゴンガス圧力10 mTorr、ターゲットとしてCu を使用、六角形回転ドラムの直径60 cm、シャッタ開発して、大角形回転ドラムの直径60 cm、シャッタ開放してを変した。 第6回転速度・成膜時間は任意として幅万向の膜厚分布を求めたものである。同回のから90 がなように30 cm角の基板内で有方して正多角が回転ドラムの分割数を12分割に増大させてドラム直径を116 cmにして膜厚の均一化を試みた形分へ、第7回に示すように幅万向に土189程度の改果が得られなかつた。

(実施例の退転条件)

ターゲットの外形寸法3インチ×18インチ (76m×457m)の矩形メーゲット41.41を 正多角形回転ドラム1の回転軸に直角方向に結ぶ 直線に対して正方向,気方向に20度の角度をか つて中心線に対して対象に2列配置し、それぞれ

8はリング状の内周磁転12と外周磁振13とに よつて形成される磁力線、3は磁力線8によつて 対じ込められている略長方形状プラズマリングで なる

このような構成においても、略長方形状プラズマリング3の相方のリニアープラズマ部分に矩形ターグット 41. 42 が配置されてリニアープラズマによつてスペッタされたスペッタ原子の重ね合わせにより、大面積高板内で展厚均一化が可能となる。この場合も前述した遅転条件による略長方形状プラズマリング3によつても同様の結果が得られ、中小量生産用として回転ドラムの直径を大きくすることなく、大面積高板内に均一な裏厚にて成膜を要する用途に大きな成力を発揮することがアタス

なか、前述した実施例にかいては、同一シャッ ター3の際口範囲内に矩形電極部41,41を中心 級に対して対称に配置した場合について説明した が、本発明は、これに限定されるものではなく、 第10回,第11回に示すように同一シャッター

特開平3-253568(4)

3 の親口範囲内でなくても正多角形回転ドラム1 に対して相対位置が同じであれば、位相がずれても同様の効果が得られる。また、第12 図に示すように矩形電極部41.41を真空容器11に対して角度をもたせて配置しても正多角形回転ドラム1 に対ける相対位度が同じであれば、同様の効果が得られる。との場合、基板2を取り付け正多角形回転ドラム1の回転軸Cに対して直角となる面に対して-6の角度を有するカソード電極部51と一6の角度を有するカソード電極部51と一6の角度を有するカソード電極部51と一8の角度を有するカソード電極部51と一8の角度を有するカソード電極を設けてこの調整機構を設けてこの調整機構を設けてこの調整できる調整機構を設けてこの調度を自在に調整できる調整機構を設けてこの調度を自在に調整できる。

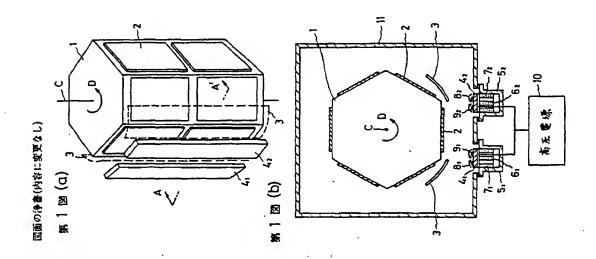
以上裁別したように本発明によれば、正多角形 回転ドラムの直径を大きくすることなく、簡単な 構成で大面積基板内に均一な腹厚でスペッタ成膜 ができるという低めて優れた効果が得られる。 4. 図面の簡単な説明

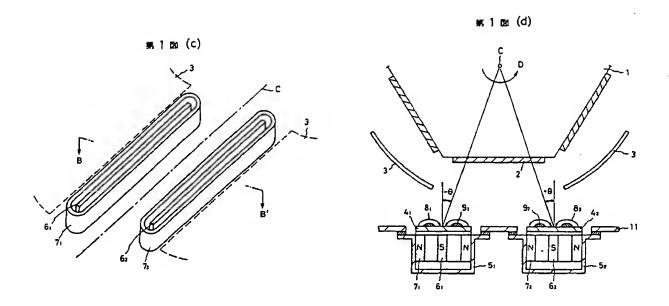
第1回は本発明によるカルーセル形スパッタリング装置の一実施例による構成を説明する図、第

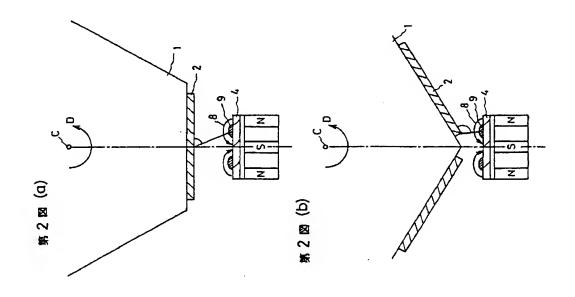
2 図は従来のカル・セル形スパッチリング集団の 緑題を設明する図、第3図~第5図は本発明によるスパッチリング方法を設明する図、第6図,第 7 図は従来の基板中央より幅万向の腹厚分布を示す図、第8図は本発明に係わる基板中央より幅万向の腹厚分布を示す図、第9図は本発明の始の実施例による構成を説明する図、第10図~第12 図は本発明のさらに他の実施例による構成を説明する図である。

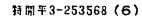
1・・・・正多角形回転ドラム、2・・・・被 成類基板、3・・・シャッター、4,41,40 ・・・・矩形ターゲット、5,51,52・・・・ カソード電極部、61,62・・・・中央磁幅、71。 72・・・外局磁幅、8,81,82・・・・ 力級、9,91,92・・・・ブラズマリング、10 ・・・高圧電源、11・・・本空容器、12 ・・・内周磁幅、13・・・外電磁値。

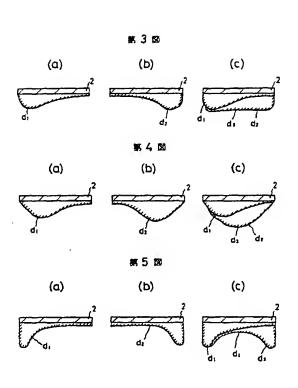
等許出題人 字部具 金 徐 式 会 社 代 理 人 山 川 政 樹

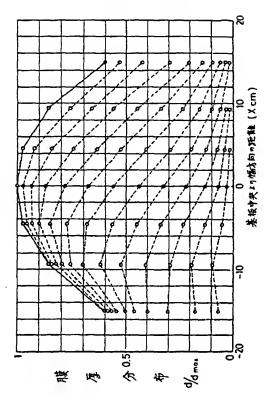


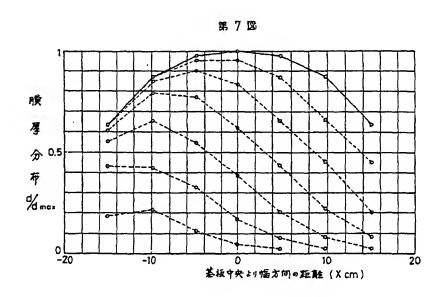






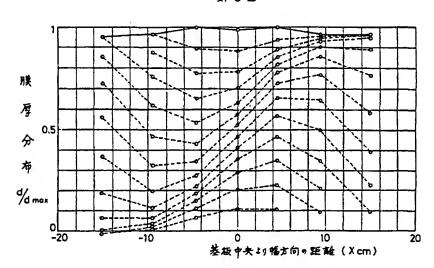


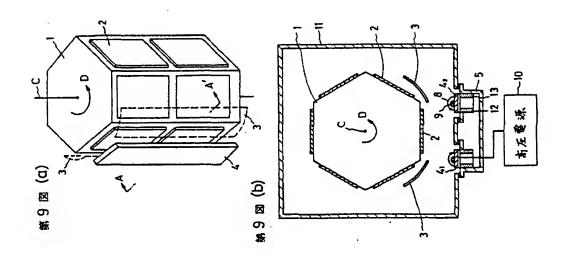


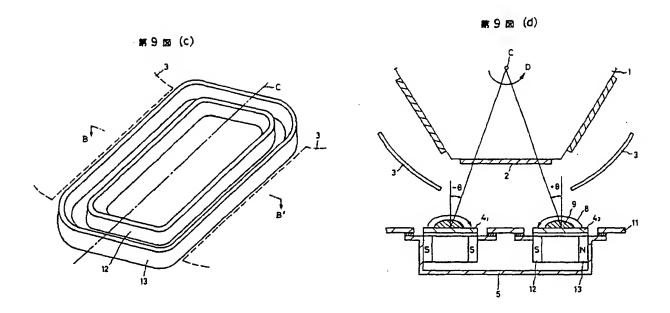


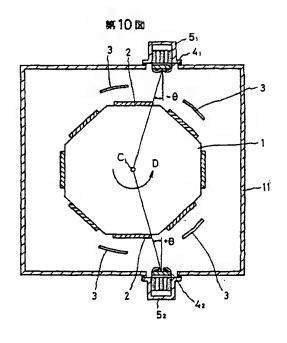
数 6 図

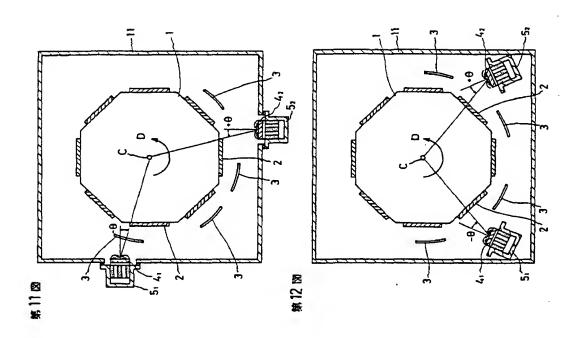
第8四











手 続 補 正 書(オ式)

特許庁長官殿

* 2.7.-3 *

1. 事件の表示

許順第51872号

2. ※明の名称 カルーセル形スパッタルか 装置およな どのスペッタリンかオ法

3. 補正をする者

事件との関係

許 出類人

名称(氏名)(OZO)字部 興 遊 株式会社

4. 代理人 〒100 BM

東京都千代田区水田町2丁目4巻2号 克 和 電 和 ビ ル 8 得 山川国際的計事哲所内 低 話 (540).096 1 (代表) FAX (531) 5 7 5 4 (6462) 弁理士 山 川 政 近天

5 日本 中の日付 平成 乙年 6月 26日

結正により増加する発明の数

6. 補正の対象

(1) 明 紅

(2) 图



7. 補正の内容

(1) 明細書の浄杏(内容に変更なし)

(2) 国面の浄谷(内容に変更なし)

停開3-253568 2 5c (2)